

半导体行业合规

Semiconductor Industry US Compliance

半月刊 (9月第2期, 2021年总第18期)

贸易合规 经济制裁 337调查
反垄断 反不正当竞争 海外投资
刑事犯罪 立法动态 业界动态



目 录

一、 贸易合规/经济制裁.....	1
(一) 美商务部就半导体产业供应链审查征求公众意见.....	1
二、 337 调查.....	2
(二) ITC 对特定具有无线通讯功能的电子设备等启动 337 调查	2
三、 反垄断/反不正当竞争.....	2
(三) 市场监管总局对三家汽车芯片销售公司加价销售芯片实施处罚	2
四、 海外投资.....	3
(四) FCC 资助农村运营商去除华为和中兴设备.....	3
(五) 美国证监会向个人投资者发出投资 VIE 架构中概股风险警示	4
五、 刑事犯罪.....	5
(六) 孟晚舟回国.....	5
六、 立法动态.....	5
(七) 《知识产权强国建设纲要(2021-2035 年)》印发.....	5

（八）红筹企业上市试点范围扩大.....	6
七、 业界动态.....	7
（九） 美国举行半导体峰会.....	7
（十） SIA 发布《2021 美国国家半导体行业报告》.....	7
（十一） 荷兰 ASML 未来十年销售预计将蓬勃发展.....	9
（十二） 美国和欧盟将针对半导体供应链共同采取行动.....	10

一、 贸易合规/经济制裁

(一) 美商务部就半导体产业供应链审查征求公众意见ⁱ

美国时间 9 月 24 日，美国商务部产业安全局(Bureau of Industry and Security)在联邦公报(Federal Register)上发布公告，为执行拜登于 2021 年 2 月 24 日发布的关于美国供应链(Executive Order on America's Supply Chains)的第 14017 号行政令（详见本半月刊 2 月第 2 期）中授权的“100 天半导体及先进封装供应链审查”，向美国国内外半导体设计公司、制造公司、材料和设备供应商以及半导体的中间和最终用户等征询意见，以加速供应链各环节的信息流通、识别供应链中的数据空缺、瓶颈以及各利益相关方的需求差异。该意见征询将于 11 月 8 日结束。

在公告中，BIS 分别向(1)半导体设计公司、前端及后端制造公司和组装公司，以及前述实体的供应商和分销商；和(2)半导体产品或集成电路的中间或最终用户提出了涉及产品属性、生产/供应情况及能力、采购情况及水平、经营中遇到的问题及原因等若干问题。

二、 337 调查

(二) ITC 对特定具有无线通讯功能的电子设备等启动 337 调查ⁱⁱ

根据中国贸易救济信息网报道，9 月 27 日，美国 Bell Northern Research LLC 根据《美国 1930 年关税法》第 337 节规定向美国国际贸易委员会(International Trade Commission, ITC)提出申请，主张对美出口、在美进口及销售的特定具有无线通讯功能的电子设备及其组件（Electronic Devices Having Wireless Communication Capabilities and Components Thereof）侵犯了其专利权。

联想集团、摩托罗拉、TCL、步步高电子、一加等被列为被告。

三、 反垄断/反不正当竞争

(三) 市场监管总局对三家汽车芯片销售公司加价销售芯片实施处罚ⁱⁱⁱ

国家市场监督管理总局于 9 月 10 日在其官方网站公布一则行政处罚信息：上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处 250 万元人民币罚款。

据国家市场监督管理总局的介绍，今年 8 月，总局成立专案组，加强价格监测，全面摸排线索。今年以来，汽车芯片生产商、授权代理商等销售芯片价格上涨幅度为 10%-15%，个别芯片上涨 50%。而受处罚的三家企业大幅度加价销售部分汽车芯片，如进价不到 10 元的芯片，以 400 多元高价销售，涨幅达 40 倍。这些行为违反了《价格法》第 14 条的规定，构成了价格违法行为，进而依法进行处罚。

国家市场监管局强调，将会继续密切关注芯片领域价格秩序，强化价格监测，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，维护良好市场秩序。

四、 海外投资

(四) FCC 资助农村运营商去除华为和中兴设备^{iv}

当地时间 9 月 27 日，美国联邦通讯委员会(Federal Communication Commission, FCC)将启动一项高达 19 亿美元的补助计划，以补偿符合条件的美国乡村电信运营商拆除被视为威胁美国国家安全的华为、中兴等电信设备。

FCC 将于 10 月 29 日开始接受申请，并于 2022 年 1 月 14 日截止。此次计划，将原符合补偿条件的拥有 200 万以下客户的电信商扩大至 1000 万以下客户的电信商。

自去年认定华为和中兴的网络通信设备可能危害美国国家安全后，FCC 先后出台若干项声明或计划，以减少直至消除这两家中国电信商的设备在美国通信网络中的存在。特别是，去年 12 月，FCC 通过规则，要求拥有华为或中兴设备的电信运营商拆除并更换这些设备。而今年 6 月，FCC 一致同意进一步禁止批准美国电信网络使用华为和中兴等五家公司的设备（详见本半月刊 6 月第 2 期）。

（五）美国证监会向个人投资者发出投资 VIE 架构中概股风险警示^v

当地时间 9 月 20 日，美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission, SEC) 在其官网向个人投资者投资在美上市 VIE 架构中概股发出三个维度的风险警示：

- 中国政府从未批准过这种架构，因此 VIE 架构在任何时候均有可能未有任何通知即被认定为违法。为此，SEC 专门列举了中概教育股作为风险例子；
- 上市实体与中国境内真正进行业务的实体（包括该实体的董事、高管和国内股东）之间的一系列协议安排均适用中国法律以及管辖；
- 真正进行业务的中国实体持有者与美国上市公司的股东之间可能存在潜在的利益冲突。

五、 刑事犯罪

(六) 孟晚舟回国^{vi}

当地时间 9 月 24 日，被羁押超过 1000 天的华为首席财务官孟晚舟在与美国司法部达成延期起诉协议(deferred prosecution agreement, DPA)后，乘坐中国政府包机返回了中国。

2018 年 12 月 1 日，孟晚舟在过境加拿大时突遭逮捕。随后，加拿大表示代表美国暂时扣留孟晚舟。同年 12 月 7 日，在孟晚舟的保释听证会上，检方指控孟晚舟涉嫌欺诈和违反美国制裁措施。

根据美国司法部新闻稿，孟晚舟认可 DPA 中对相关事实的声明的准确性，而美国撤回向加拿大提出将孟晚舟引渡至美国的要求。如果孟晚舟不违反 DPA，美国将不会再起诉孟晚舟。需要注意的是，DPA 并不表示美国会停止起诉华为，而孟晚舟对于相关事实的承认有可能会被美国司法部在已经立案对华为的诉讼中作为证据。

六、 立法动态

(七) 《知识产权强国建设纲要(2021-2035 年)》印发^{vii}

近日，党中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》（“《纲要》”）。《纲要》面向知识产权事业未来 15 年发展，为统筹推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、

运用、保护、管理和服务水平，充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用指明了方向。

《纲要》提出，到 2025 年，知识产权强国建设取得明显成效。到 2035 年，我国知识产权综合竞争力跻身世界前列，中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。

（八）红筹企业上市试点范围扩大^{viii}

9 月 17 日，证监会发布了《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》（“《公告》”）。

根据《公告》，除《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》明确的互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药行业外，属于新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红筹企业，纳入试点范围。

值得一提的是，具有国家重大战略意义的红筹企业申请纳入试点，不受前述行业限制。

《公告》还明确，红筹企业申请纳入试点，应当符合《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》等规定的其他条件。

七、 业界动态

(九) 美国举行半导体峰会^{ix}

当地时间 9 月 23 日，美国白宫再次召集半导体业界相关人士讨论芯片供应链问题。这次会议由美国商务部长 Gina Raimondo 和白宫经济顾问 Brian Deese 共同主持，芯片制造厂商以及芯片最终用户的汽车行业、消费电子行业与医疗器材行业从业者，如台积电、Intel、苹果、微软、三星、美光、通用汽车、福特和宝马等都有派代表出席。

此次会议旨在解决全球芯片短缺问题。但在会上，美国要求参会企业披露美国供应链的具体信息，包括芯片库存、订单和销售记录等，这些信息被要求在接下来的 45 天内提交。白宫则表示，这样做的原因在于“了解和量化可能存在的瓶颈”。

(十) SIA 发布《2021 美国国家半导体行业报告》^x

当地时间 9 月 24 日，美国半导体行业协会(Semiconductor Industry Association, SIA)发布了长达 27 页的《2021 年美国国家半导体行业报告》(2021 State of the US Semiconductor Industry)，对今年美国半导体行业的情况和形势做了总的分析和概括。

报告指出，2020 年和 2021 年缺芯问题引起了全球关注，市场需求引致了前端晶圆生产厂的产能利用率超过了 80%，甚至有些厂

家高达 100%。如今，全球半导体行业正在加大制造和研发投资，以满足未来市场增长。

根据世界半导体贸易统计组织的数据，2021 年全球半导体销售额将达到 5270 亿美元，2022 年则可能达到 5730 亿美元。整体来看，2020 年全球半导体需求最高的是电脑，然后依次为智能手机、消费电子、工业和汽车。如果以地区来看，美国半导体公司的销售额占据了全球将近一半的市场份额，然后依次为韩国、日本、欧洲和中国等。

这份报告特别指出了美国半导体行业的支柱和欠缺。比如，美国半导体行业在 EDA、IP、芯片设计和半导体设备等环节处于领先地位，而在硅片等原材料、封装、测试等环节处于落后。而在芯片制造方面，美国本土欠缺 10 纳米以下逻辑芯片制造能力，而在模拟芯片和存储上处于领先地位。

报告特别指出，美国在芯片设计方面的优势特别突出，拥有最多的设计人才。就研发支出占行业销售额比例来说，美国半导体行业的研发支出占比仅次于制药和生物技术行业，且高于其他国家的半导体行业。

SIA 指出，美国半导体行业对其国内经济至关重要。美国从事半导体设计、制造、测试和研发的人员超过 27.7 万，能够影响 2600 多万美国工人。就出口而言，2020 年美国半导体总出口额达 490 亿美元，仅次于飞机、成品油和原油。

SIA 同时呼吁美国出台激励半导体发展的法案，盖因为过去十年，海外芯片制造产出的平均增长率是美国的五倍，而到 2030 年，中国大陆可能占据全球最大的芯片制造份额。

最后，SIA 对美国半导体发展提出了一些建议：

- 加强投资，包括出台投资抵免税收的鼓励性政策；
- 加强技术人才的实力和吸引力，改善教育，吸引高科技人才移民；
- 促进自由贸易和知识产权保护，扩大信息技术协定；
- 加强合作，以半导体供应链全球属性为基础，塑造更有利于增长、创新和供应链弹性的监管和法律环境。

(十一) 荷兰 ASML 未来十年销售预计将蓬勃发展^{xi}

ASML 是一家生产用于世界各地制造先进芯片的光刻设备的公司，在其针对投资者的一份声明中说到，该公司目前预计，到 2025 年，年收入将达到 240-300 亿欧元（约合 280 亿至 350 亿美元），毛利率将高达 54% 至 56%。

ASML 表示，“电子行业的全球大趋势”，加上“高利润和极具创新性的生态系统”，预计将继续推动整个半导体市场的增长。该公司补充称，半导体市场的增长和“日益加大的光刻强度”正在推动对其产品和服务的需求。

ASML 总部位于维尔德霍芬，是世界上唯一一家能够制造芯片制造商制造最先进芯片所需的精密机器的公司。这些芯片比前代芯片更快、更高效。

ASML 的客户包括三星和台积电，后者为苹果等公司生产芯片。

路透社去年报道，特朗普政府向荷兰政府施压，要求其停止向中国客户销售该机器。

市值为 3220 亿美元的 ASML 在阿姆斯特丹上市的股票周三早盘上涨 1.7%，今年以来已上涨 70%。

(十二) 美国和欧盟将针对半导体供应链共同采取行动^{xii}

美国和欧盟的政府高级官员定于 9 月 29 日在匹兹堡召开美欧贸易和技术理事会（TTC）首次会议，旨在扩大和深化贸易和跨大西洋投资关系。

TTC 设有 10 个工作组，旨在解决供应链安全、出口管制、全球贸易挑战和其他问题。它将为两国政府协调和推动健全的半导体政策提供一个重要场所，以加强我们的集体供应链弹性，刺激行业增长和创新。

美国和欧盟半导体行业紧密相连，将在相关政策、研究和环保举措等广泛领域开展合作。到 2020 年，美国和欧盟的总和占全球半导体制造能力的 21%，2019 年占全球半导体数字设备消费量的 43%。2020 年，美国和欧盟之间的双向半导体贸易总额达 48 亿美元。美国和欧盟也对全球半导体供应链的潜在脆弱性和过度依赖性也有着类似的担忧，尤其是在东亚部分地区。

SIA 确定了美国和欧盟可以合作的四个具体领域，以加强半导体供应链的弹性，促进创新和贸易。

1.美国美国和欧盟应就半导体政策和战略保持密切协调和信息交流。虽然地理专业化为全球半导体行业及其消费者提供了良好的服务,但它也在全球价值链中造成了潜在的脆弱性,因为已经出现了几个因素,可能使这一全球模式的成功延续面临风险。作为回应,两国政府都提出了半导体相关立法——美国创新与竞争法案(USICA)和欧盟芯片法案——并计划投资于供应链中的高风险缺口,并建立一个地理上更加多样化的供应商基础。在两国政府出台和实施这些政策时,应共同分析半导体行业的综合优势和劣势,确保每个地区的激励计划向最具全球创新性的公司开放,并促进各地区激励计划的信息共享和透明度。

2.美国和欧盟应深化在跨大西洋研发方面的合作。加快技术创新对于加强供应链的复原力至关重要。欧盟拥有许多世界领先的全球半导体研究机构,包括比利时的IMEC、法国的CAE-LETI和德国的弗劳恩霍夫-格塞尔沙夫特。此外,美国《芯片法案》还要求建立一个国家半导体技术中心(NSTC)和一个先进的包装研究所。TTC应提供一个场所,以便加强现有和新的协作,并利用这些合作来解决供应链漏洞。

3.美国和欧盟应该加强对国有企业和扭曲性工业补贴的管理。国企活动和产业补贴受政府影响或政府影响,而不是商业考虑,可能会造成有害的市场和投资。虽然国有企业不是美国和欧盟半导体的主要消费者,但在其他非市场经济国家中,它们是重要的参与者。因此,贸易贸易委员会的一项关键任务应该是在全球贸易政策和治理中重新发挥领导作用,重点是解决现有贸易规则没有充分解决的歧视性和扭曲市场的做法。

4.美国和欧盟应确保制定协调和有针对性的出口管制政策。多边出口管制比单边管制有效得多,这可能导致生态系统和全球供应链的支离破碎。在美国和欧盟考虑出口管制政策时,双方应确保多边和跨

大西洋的针对性半导体出口管制政策与直接和切实的国家安全风险挂钩。建议任何出口管制措施都应评估其对美国和欧盟工业和创新基地的影响，这对这两个地区的经济弹性和国家安全都很重要。

集成电路知识产权联盟（ICIP Alliance）是在工业和信息化部科技司、工业和信息化部电子信息司及国家和地方相关主管部门指导下，由国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所，简称“国家工信安全中心”）牵头发起、于2016年1月20日正式成立的行业性、非营利性社会组织。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为联盟名誉理事长单位，国家工信安全中心为联盟理事长单位，联盟秘书处设在国家工信安全中心-CIC 赛昇计世资讯。联盟成员覆盖集成电路设计、制造、封装、测试、相关装备和材料等产业链上下游企业及标准化、科研院所、相关软件开发、系统集成、互联网、内容与服务等企事业单位及社会团体组织，旨在整合全产业链资源，积极营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊重和加强知识产权保护、重视和加强合规管理的环境与氛围。

若有相关问题需要咨询或了解集成电路知识产权联盟，欢迎联系杨晓丽秘书长 65463692@qq.com 或中集知联小助手：ICIP_Alliance 或关注“中集知联”微信公众号查看更多信息。

美国奥斯顿律师事务所（Alston & Bird LLP）成立于1893年，在全球范围设有13家办公室，拥有约800多名律师，是一间面向全球的综合性国际律师事务所，为国内及跨国客户提供跨越多行业的最优法律服务。奥斯顿的国际贸易与合规团队是各大国际律所中少有的专业从事贸易合规相关业务的团队。它以美国华盛顿特区为核心辐射全球，为各类跨境商业活动提供合规咨询和法律支持，成功协助了各行业各类客户处理了各类复杂和敏感的国际贸易和法律合规事宜。依托原本就十分坚实的知识产权业务基础，半导体行业是奥斯顿国际贸易与合规团队近年来的执业重点，数年来已经为诸多业界领跑者提供了大量卓有成效的法律服务。

本半月刊中的任何内容并不构成本所的任何法律意见或建议。若对本半月刊的内容有任何问题或需要进一步了解奥斯顿律师事务所，欢迎联系李奕律师 yi.li@alston.com 或徐静婷 jing.xu@alston.com。

ⁱ 参见:

<https://www.federalregister.gov/documents/2021/09/24/2021-20348/notice-of-request-for-public-comments-on-risks-in-the-semiconductor-supply-chain>。

ⁱⁱ 参见: <https://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ssqdc?articleId=170797&type=>。

ⁱⁱⁱ 参见: http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202109/t20210910_334620.html。

^{iv} 参见:

<https://www.fcc.gov/document/fcc-announces-supply-chain-reimbursement-program-filing-window>。

^v 参见:

<https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-95>。

^{vi} 参见:

<https://www.justice.gov/opa/pr/huawei-cfo-wanzhou-meng-admits-misleading-global-financial-institution>。

^{vii} 参见: http://www.gov.cn/zhengce/2021-09/22/content_5638714.htm。

^{viii} 参见: http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202109/t20210917_405530.htm。

^{ix} 参见:

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/23/readout-of-biden-administration-convening-to-discuss-and-address-semiconductor-supply-chain/>。

^x 参见: <https://www.semiconductors.org/state-of-the-u-s-semiconductor-industry/>。

^{xi} 参见:

<https://www.cnbc.com/2021/09/29/asml-predicts-sales-boom-as-demand-for-chip-making-machines-surges.html>

^{xii} 参见:

<https://www.semiconductors.org/actions-the-u-s-and-eu-can-take-together-to-strengthen-both-regions-semiconductor-supply-chain-resilience/>